Úvod do informačních technologií

Jan Outrata



KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

přednášky



Osobní počítač



Obrázek: Počítač IBM PC (1981)

Personal Computer, PC

- příbuznost a (částečná nebo úplná) kompatibilita s počítači IBM PC (1981), procesory Intel x86 kompatibilní
 - XT (eXTended, 1983) 8-bitový, procesor Intel 8088, 4,77 MHz, 16–256 kB RAM, operační systém MS DOS
 - AT (Advanced Technology, 1984) 16-bitový, procesor Intel 80286, 6/8 MHz, 256 kB až 16 MB RAM
 - ztráta vlivu na standardizaci po PS/2 (1987), ve prospěch firem Intel (hardware) a Microsoft (software)
- = základní koncepce technického provedení počítače
- dodnes převládající koncepce mikropočítačů (otevřená politika IBM vs. uzavřená jiných firem)

Osobní počítač





Počítačová sestava



Počítač, počítačová sestava = "stavebnice" počítače s modulární architekturou ⇒ variabilita, rozšiřitelnost, vyváženost, . . .

- hardware = technické vybavení počítače, fyzické součásti ("železo"), elektronická digitální a elektromechanická zařízení
- software = programové vybavení počítače, operační systém a aplikace, firmware = programy vestavěné do hardware (např. BIOS)
- neustálý vývoj, posouvání hranic možností, specializace



Obrázek: Počítačová skříň

Skříň (case, chassis)

- provedení (form factor): klasické desktop, (mini/midi/big)tower, rack, notebook/ultrabook/..., tablet?, embedded atd.
- korespondence s rozměry základní desky (otvory pro zdroj, konektory, lišty pro přídavné karty)
- = kovová (plechová) konstrukce s plastovými kryty
- **sachty** pro mechaniky výměnných médií a panely konektorů (5, 25'', 3, 5''), tlačítka pro zapnutí, popř. reset, signalizace a indikátory (LED aktivit, detekce otevření) aj.
- výrobci: Antec, AOpen, ASUS, Chieftec, Cooler Master, DFI, Ever Case, Foxconn a další







Obrázek: Zdroj napájení

Zdroj napájení (power supply) nebo Baterie

- zajišťuje el. napájení stejnosměrným proudem všech (vnitřních) součástí počítače
- konektory PC Main (P1, 20/24 pinů, do základní desky), ATX12V (P4, 4/8 pinů, do základní desky, pro procesor), 4- a 15-pinové (pro disková zařízení PATA, SATA),
 6/8-pinové (pro PCI-Express), a IEC C14 pro elektrickou šňůru
- typicky $+3.3, \pm 5, \pm 12~V$, 250–1000 W pro osobní počítače, 25–100 W pro přenosné s baterií, více zdrojů (redundantních) pro servery a pracovní stanice, efektivita od 75 do 90 %
- korespondence s rozměry základní desky (konektory) a skříně, AT nebo ATX
- výrobci: Antec, Enermax, Foxconn a další









Obrázek: Ilustrace počítače

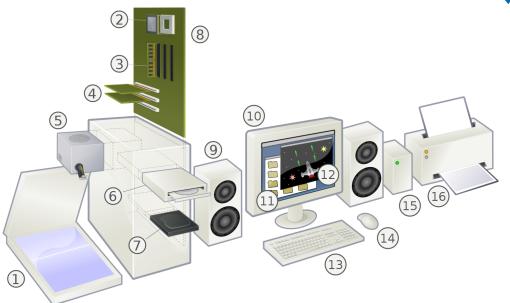
Vnitřní součásti: základní deska, procesor, operační pamět, rozšiřující karty (grafická, zvuková, síťová aj.), pevné disky, mechaniky výměnných médií (CD/DVD, floppy, aj.), zdroj, ventilátory

Vnější součásti: displej, klávesnice, myš, touchpad

Periferie: disková zařízení (pro pevné disky i výměnná média), síťová zařízení (přepínače, směrovače, přístupové body, modemy aj.), multimediální zařízení (reproduktory, mikrofon, webová kamera, antény), tiskárna, plotter, skenner, tablet, trackball, joystick a další

některé vnější součásti a periferie mohou být součástí skříně (notebook, tablet, Mac), např. displej, klávesnice, touchpad, síťová a multimediální zařízení aj.



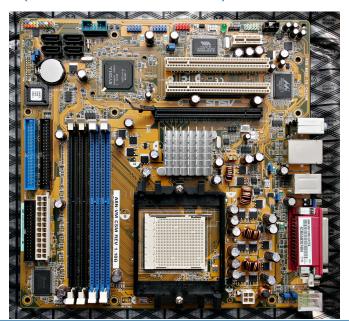




Obrázek: Základní deska

- = základní součást, ke které (na kterou) se připojují další zařízení, které propojuje: procesor(y), paměti, přídavné karty, disková zařízení, periferie a další
- vícevrstvý (obvykle) obdélníkový plošný spoj s obvody propojujícími zařízení pomocí vnitřních sběrnic







- formáty (form factor):
 - PC/XT (IBM) první pro osobní počítače
 - AT (IBM) 305×350 mm, varianta Baby
 - ATX (Intel, 1995) 244×305 mm, nejpoužívanější, de facto standard, varianty micro, mini, Extended, Flex, Ultra, DTX (203×244 mm)
 - \blacksquare BTX (Intel) 266×325 mm, lepší chlazení a napájení než ATX, varianty micro, Extended aj., neujal se
 - \blacksquare ETX (95 imes 114 mm), ITX (mini, nano, pico, mobile) v embedded počítačích
 - odpovídající skříň, různé konektory pro napájení od zdroje, různé rozmístění konektorů pro periferie
- výrobci: Aopen, ASRock, ASUS, Biostar, EPoX, Foxconn, Gigabyte Technology, Intel, Jetway, Micro-Star, Palit, Soyo, VIA a další



Sběrnice (bus)

- paralelní nebo sériová soustava vodičů propojujících zařízení pro komunikaci a přenos dat (řízeným protokolem)
- parametry:
 - šířka přenosu (bit) určuje, kolik bitů lze najednou přenést
 - frekvence (MHz) frekvence hodinového signálu
 - rychlost/propustnost (MB/s) určuje množství dat přenesených za jednotku času, frekvence × šířka (v bytech)
- vnitřní: na základní desce (součást jejích obvodů), vesměs paralelní
- vnější (rozhraní): k diskovým zařízením a periferiím, kombinované nebo sériové
- synchronní zařízení synchronizována, většina vnitřních
- multimaster může být řízena více zařízeními než jedním (typicky procesorem), tzv.
 busmastering



Sběrnice (bus) – části:

- adresová výběr adresy v paměti nebo zařízení na sběrnici, šířka 3 až 64 bitů určuje, s jak velkou pamětí nebo s kolika zařízeními lze (přímo) pracovat
- datová přenos dat po sběrnici, šířka 1 až 128 bitů, udává "bitovost" sběrnice
- řídící řízení zařízení na sběrnici pomocí řídících a stavových informací, šířka 1 až 8 bitů určuje počet řídících signálů a stavů



Vnitřní sběrnice

procesorová, systémová (CPU, front side bus)

- propojuje procesor(y) a severní můstek čipsetu, příp. řadič kanálů (periferní procesory, u mainframe počítačů)
- 8- až 64-bitová, šířka datové části (většinou) koresponduje s adresní
- frekvence (FSB): 66, 100, 133, 200, 266, 400
- patice (socket), příp. slot = konektor pro procesor

paměťová (memory bus)

- propojuje operační paměti a severní můstek čipsetu
- frekvence FSB
- sloty = konektory pro operační paměti



Vnitřní sběrnice

rozšiřující, lokální (expansion, local bus)

- určuje standard pro připojená zařízení přídavné karty
- **sloty** pro karty: grafické, zvukové, síťové, multimediální, diskové řadiče, pro periferie aj.
- integrované karty součástí základní desky, dnes běžně zvuková, síťová, diskové řadiče, někdy i grafická (tzv. all-in-one)
- ISA (Industry Standard Architecture) nejstarší pro IBM PC, původně pro procesor Intel 80286, 8/16-bitová, frekvence 4,77/8,33 MHz, manuální konfigurace karet pomocí tzv. jumperů (propojka vodičů) nebo v BIOSu, dnes se u osobních počítačů téměř nevyskytuje, přetrvává v průmyslových počítačích
- MCA (Microchannel Architecture) od IBM pro procesory Intel 80386 jako náhrada za ISA, 16/32-bitová, frekvence 10–25 MHz, umožňuje busmastering, nekompatibilní s ISA, nerozšířila se mimo IBM (PS/2)



Vnitřní sběrnice

rozšiřující, lokální (expansion, local bus)

- EISA (Extended ISA) zpětně kompatibilní s ISA, pro procesory Intel 80386, 8/16/32-bitová, frekvence 8,33 MHz umožňuje busmastering, dnes nepoužívaná
- VLB (VESA Local Bus) pro procesory Intel 80486, 32-bitová, závislá na ISA, počet slotů klesá s frekvencí 25–50 MHz (např. 3 při 33 MHz, 1 při 40 MHz), dnes nepoužívaná
- PCI (Peripheral Component Interconnect)
 - od Intelu pro procesory Intel Pentium, umožňuje busmastering
 - umožňuje zařízením přímý přístup do operační paměti, použití i v jiných počítačích než IBM PC kompatibilních
 - 64-bitová (Pentium), 32-bitové přenosy (pro procesory Intel 80486)
 - frekvence 33, 66, 100, 133 MHz
 - Plug & Play (PnP, 1992, Intel, Microsoft, Compaq) standard pro automatickou konfiguraci karet, typu, parametrů a bezkonfliktní přiřazení zdrojů (viz BIOS)
 - univerzální pro všechny typy karet, dnes postupně nahrazována PCI Express



Vnitřní sběrnice

rozšiřující, lokální (expansion, local bus)

- AGP (Accelerated Graphic Port)
 - od Intelu pro procesory Intel Pentium II
 - propojení grafických karet přímo s procesorem a operační pamětí (podobně jako procesorová sběrnice)
 - 32-bitová, frekvence základní 66 MHz = AGP $1\times$, pak AGP $2\times, 4\times, 8\times$ různý počet bitů za takt
 - dnes nahrazena PCI Express
- PCI Express (PCI-E)
 - nástupce PCI (a AGP), ne zpětně kompatibilní! (existuje zpětně kompatibilní rozšíření
 PCI-X)
 - 1–32-bitová, 1,25 GHz
 - $1\times, 4\times$ (různé karty), $8\times, 16\times$ (grafické karty), verze 4.0
- další: průmyslové (VME), ACR, AMR, CNR pro připojení modemových a zvukových karet, dnes nepoužívané



Vnější sběrnice a rozhraní

Na ploše základní desky:

- rozhraní/sběrnice pevných disků a mechanik výměnných médií (CD/DVD, pam. karty aj.): IDE/PATA, (m)SATA, SCSI, Fibre Channel, M.2
- patice pro cache paměti, BIOS
- rozšiřující konektory: pro sběrnice USB, FireWire, zvukové konektory
- konektory (piny) pro další zařízení: napájení, aktivní chladiče (ventilátory), tlačítka, signalizace a indikátory, reproduktor ve skříni aj.

Konektory na (zadním) panelu základní desky:

- integrovaných karet: zvukové (stereo jack, optické), síťové (RJ-45), grafické (VGA = D-SUB, DVI, HDMI, DisplayPort)
- vnějších sběrnic USB, FireWire, eSATA, I²C, pro periferie
- vstupně/výstupních periferií (čip Super I/O): klávesnice, myš (PS/2), paralelního (Centronics, LPT), sériového (RS 232, COM), MIDI, infra rozhraní (porty)

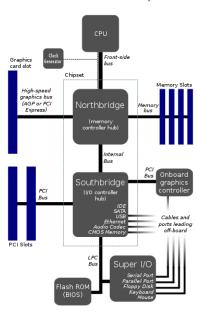


Obrázek: Blokové schéma základní desky

Čipová sada (chipset)

- integrované obvody (s pasivním chladičem) na základní desce pro řízení pamětí a sběrnic, propojení procesoru, sběrnic a připojení dalších zařízení
- konstruované pro konkrétní typy a počty/množství procesorů a pamětí
- severní můstek, systémový řadič (north bridge, memory controller hub)
 - propojuje procesorovou a paměťovou sběrnici (procesor, paměti) s vnitřními sběrnicemi (AGP, PCI Express) a jižním můstkem (můstky, interní sběrnice)
 - obsahuje, pokud je, integrovanou grafickou kartu
 - dříve (dnes součást procesoru) obsahoval např. řadič operační paměti a řadič cache paměti (= vyrovnávací paměti mezi různě rychlými zařízeními na frekvenci rychlejšího, např. procesorem a operační pamětí)







Obrázek: Blokové schéma základní desky

Čipová sada (chipset)

- jižní můstek, vstupně/výstupní řadič (south bridge, I/O controller hub)
 - propojuje severní můstek a vnitřní sběrnice (PCI, PCI Express) s vnějšími, příp. se sběrnicí ISA
 - obsahuje např. řadič diskových zařízení a polí, řadič DMA (Direct Memory Access, umožnění přímého přístupu zařízení do operační paměti), řídící obvody vnějších sběrnic a rozhraní, připojení čipu BIOSu (sběrnice LPC k čipu Super I/O), další integrované karty (zvuková, síťová aj.)
- výrobci: Intel, AMD, NVidia, VIA Technologies, SiS a další

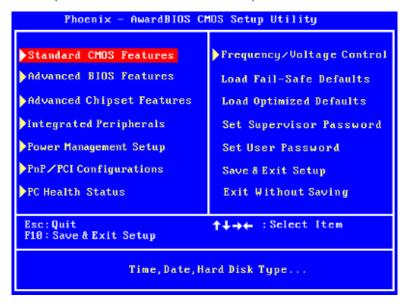


Obrázek: Hlavní obrazovka BIOSu

BIOS, Basic Input Output System

- program poskytující základní nízkoúrovňové služby: start počítače, vstupní (obsluha klávesnice, myši), výstupní (text, grafika), dále např. datum a čas, správa napájení, síťové aj.
- rozhraní mezi hardwarem a operačním systémem
- umožňuje základní konfiguraci hardwaru počítače (tzv. SETUP): zapnutí/vypnutí zařízení, základní nastavení zařízení (parametrů, přiřazení zdrojů přerušení, DMA kanály, vstupní/výstupní adresy, přiřazený paměťový rozsah aj.), zařízení pro zavedení operačního systému apod.
- = firmware uložený v paměti ROM (Flash EEPROM) na základní desce
- konfigurační data v paměti CMOS RAM zálohované baterií
- výrobci: Award, Phoenix, Ami







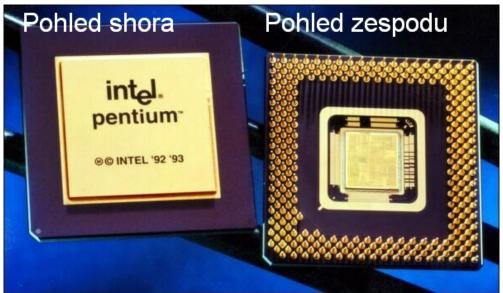
- nejvíce ovlivňuje kvalitu počítačové sestavy, zvláště vzhledem k dalšímu rozšiřování a modernizaci
- parametry: typ patice/slotu pro procesor(y) a použitelné procesory, chipset, počet a typy slotů pro paměti a přídavné karty, integrované karty, rozhraní a konektory pro periferie, rychlosti sběrnic



Obrázek: Procesor

- centrální prvek počítače vykonávající sekvenčně (až na skoky) instrukce programu uloženého v operační paměti
- mikroprocesor = integrovaný obvod/čip (velmi vysokého stupně integrace) v patici (socket) nebo slotu na základní desce
- pasivní (dříve) a aktivní chlazení (ventilátor)
- "mozek počítače"







části:

- řadič (řídící jednotka, central unit, CU) zpracovává instrukce programu nad daty čtenými z registrů, paměti nebo vstupního zařízení, výsledy zapisuje do registrů, paměti nebo výstupního zařízení
- aritmeticko-logická jednotka (ALU) realizuje aritmetické a logické instrukce, celočíselná a v plovoucí řádové čárce
- registry paměťové buňky přímo v procesoru, nejrychleji dostupná paměť procesoru
- vyrovnávací paměti cache (L1, L2, L3), řadič cache
- sběrnicová a stránkovací jednotka, řadič operační paměti, ...
- dnes navenek von Neumannova koncepce, vnitřně harvardská

frekvence:

- vnitřní (taktovací) nominální frekvence procesoru, 1 MHz až několik (3+) GHz, odvozena od frekvence FSB pomocí násobitele nastavovaného jumpery (dříve) nebo v BIOSu, násobky 0,5, rozsah 1,5 až 15 (u nových procesorů), typicky od 3 do 7,5
- vnější frekvence FSB, určená severním můstkem chipsetu



- patice (socket): vývody procesoru ve formě pinů (dříve) nebo plošek (dnes), téměř výhradní, např. DIP (40 pinů) pro Intel 8086/8, PLCC (68 pinů) pro Intel/AMD 80186-386, Socket 1–3 (169–238 pinů) pro Intel/AMD 80486, Intel Pentium OverDrive, Socket 4,5,7 (273–321 pinů) pro Intel Pentium (MMX), AMD K5, K6, Socket 370 (370 pinů) pro Intel Celeron, Pentium III, Socket 478 pro Intel Celeron, Pentium 4, Socket A/462 pro AMD Athlon (XP), Duron, Socket 754 pro AMD Athlon 64, Socket 940 pro AMD Opteron, Socket 775 pro Intel Pentium 4/D, Celeron, Core 2, Socket AM2/+ pro AMD Athlon 64, Opteron, Sempron, Phenom, Socket 1155/1366/2011 pro Intel Core i3/5/7, Socket FM1/2 pro AMD A4/6/8/10 a další
- slot: podobně jako přídavné karty do rozšiřujících sběrnic, vyjímečně, např. Slot 1 (242 pinů) pro Intel Celeron, Pentium Pro, II a III, Slot 2 (330 pinů) pro Intel II Xeon, Slot A (242 pinů) pro AMD Athlon K7
- výrobci (pro osobní počítače): Intel, AMD, ARM Ltd., VIA Technologies, IBM,
 Transmeta, Texas Instruments a další specializované



Instrukční sada

- = množina všech instrukcí procesoru, pevně zabudována nebo upravitelná/rozšiřitelná instrukce složeny z tzv. mikroinstrukcí
- CISC (Complete Instruction Set Computer) tzv. úplná instrukční sada, všechny možné déle trvající instrukce, u osobních počítačů navenek procesoru, např. Intel, AMD
- RISC (Reduced ISC) redukovaná instrukční sada, jen několik základních jednoduchých rychlých (mikro)instrukcí, ostatní složitější jsou složeny ze základních, např. IBM Power PC, u osobních počítačů interně u novějších procesorů Intel, AMD
- instrukce přesunu (mezi registry, operační pamětí), aritmetické, logické (log. operace, posuvy, rotace), skoku, vstupně/výstupní (pro práci s periferiemi), ostatní (řídící aj.), a další
- matematického koprocesoru pro operace v plovoucí řádové čárce (Floating Point Unit, FPU)
- rozšíření o specializované instrukce např. multimediální (MMX, 3DNow!, SSE), vektorové (AVX) aj.



Registry

- = paměťové buňky přímo v procesoru, pro potřeby vykonávání instrukcí
- velikost podle datové části procesorové sběrnice, 8, 16, 32, 64 bitů
- univerzální (datové) pro operandy, mezivýsledky a výsledky instrukcí, např. EAX (RAX), EBX (RBX) atd.
- se stanoveným významem pro řízení vykonávání programu, např. EIP, ESP, EFlags, pro implicitní operandy a výsledky, např. ESI, EDI, pro řízení procesoru, např. CRx aj.
- matematického koprocesoru FPx
- dalších jednotek procesoru a rozšíření instrukčních sad



Procesory Intel

- vedoucí výrobce procesorů pro osobní počítače, od 1972 i další (IBM, AMD, ARM) viz literatura
- **4004** (1971) první, 4-bitový, 108 kHz, 2 300 tranzistorů
- 8008 (1972), 8080 (1974), 8088 (1979) 8-bitové, 2–5 MHz, 6–29 tis. tranzistorů
- **8086** (1978) 1. 16-bitový
- **80286** (1982) 16-bitový, 24-bitová adresová, až 12 MHz, 130 tis. tranzistorů
 - reálný režim po inicializaci procesoru, podle 8086
 - chráněný režim zapnutí instrukcí z reálného (bez možnosti zpět), stránkování paměti (stránky = kusy fyzické paměti) a virtuální paměť, adresace až 16 MB fyzické operační paměti a 1 GB virtuální, 4 úrovně ochrany programu (Ring 0 až 3)



Procesory Intel

- **80386** (1985) 1. 32-bitový, vnější 16 MHz, 280 tis. tranzistorů, verze SX (do základních desek pro 16-bitový 80286), DX, **segmentace paměti** (segmenty = oblasti virtuální paměti programu s různými právy), 32-64 kB **L2 cache** na základní desce
- 8087, 80287, 80387SX, 80487SX **matematické koprocesory**, na základní desce vedle procesoru
- 80486 (1989) vnější 25 MHz, 1,2 mil. tranzistorů, verze SX (vylepšený 80386, 8 kB L1 cache), DX, DX/2 (dvojnásobná vnitřní frekvence), DX/4 (trojnásobná), integrovaný matematický koprocesor, pipelining = více rozpracovaných instrukcí zároveň
- Pentium (1993) 64-bitový (vnitřně 32!), 32-bitová adresová, vnější 60 MHz, 3.1 mil. tranzistorů, 16 kB L1 (8 kB pro instrukce, 8 kB pro data, harvardská koncepce), rysy RISC instrukční sady, superskalární architektura = více (2) proudů vykonávání instrukcí, umožňuje provádět více (2) instrukcí současně, 2 ALU, "předvídání" cílové adresy instrukcí podmíněných skoků, klony AMD K5, Cyrix M1



Procesory Intel

- Pentium MMX (MultiMedia eXtension), MMX2 až 200 MHz, 57 a 70 (vektorových) instrukcí pro zpracování multimediálních dat (s opakujícími se smyčkami, paralelní vykonávání, s plovoucí řádovou čárkou, využití registrů FPU), architektura SIMD (Single Instruction Multiple Data, paralelní zpracování dat vektorů dat), data zpracovávána po 64 bitech
- Pentium Pro (P6, 1995) 36-bitová adresní část sběrnice, druhý čip v pouzdře pro 256 kB až 1 MB L2 cache, RISC jádro, 5 paralelních jednotek (2 ALU, 2 sběrnicové, 1 FPU)
- Pentium II (1997) od 233 MHz, vnější 100 MHz, 7,5 mil. tranzistorů, nové pouzdro (S.E.C.) do slotu Slot 1, verze Xeon pro servery a pracovní stanice (vyšší výkon), Mobile (M) pro notebooky (nižší spotřeba)
- Celeron vnější 66 MHz, bez L2 cache → pomalý, od verze 300A 128 kB L2 cache, Slot 1, pouzdro (PPGA) do patice Socket 370 (existuje redukce na Slot 1)

Procesor (central processing unit, CPU)



Procesory Intel

- Pentium III (1999) od 400 MHz, vnější až 133 MHz, 9,5 mil. tranzistorů, dvě výrobní technologie (0,25 a $0,18\mu m$ vyšší výkon, nižší spotřeba, 1,6 V místo 2 V), integrovaná 256kB L2 cache na čipu, 70 nových instrukcí SSE (Streaming SIMD Extensions) pro 3D
- Pentium 4 (2000) od 1,3 GHz, vnější 400 a 533 MHz (technologie DualBus dvojice paměťových karet), 42 mil. tranzistorů, plošky, nové jádro, architektura NetBurst vyšší frekvence, ale i spotřeba (potřeba zdroje ATX-P4 s přídavným konektorem), další cache (např. Execution Trace Cache pro dekódované makroinstrukce), dalších 144 instrukcí SSE2 pro plovoucí řádovou čárku, verze HT (HyperThreading) zdvojené registry, simulace dvou procesorů
- Itanium (2001) 1. plně 64-bitový, instrukční sada IA-64 (Itanium), pro servery a pracovní stanice
- Core (2006) vícejádrové, SSE 3/4, VTx/d, sdílená až 2/6MB L2 cache, verze Solo, Duo (32-bitové), Core 2 (64-bitové), Duo, Quad (2× cache), Extreme, i3/5/7/9 (až 12 MB L3 cache, různé mikroarchitektury)



- = paměťové zařízení pro ukládání (binárních) dat
- parametry:
 - kapacita, přenosová rychlost, přístupová doba (doba od požadavku do vydání dat), spolehlivost (doba mezi poruchami)
 - energetická závislost (neudrží data bez el. napájení, volatilní), způsob přístupu (přímý, sekvenční od začátku paměti), druh (statické/dynamické – obsah potřeba periodicky obnovovat) a další
 - cena za bit v závislosti zejm. na kapacitě (nepřímo) a přenosové rychlosti (přímo)



- vnitřní pro krátkodobé ukládání kódu a dat spuštěných programů, např. registry procesoru, operační a vyrovnávací paměť, přídavné karty, a trvalé uložení firmware a základních konfiguračních dat počítače, např. BIOS, přídavné karty
 - menší kapacity (do desítek GB), vyšší přenosové rychlosti (až desítky TB/s), přístupová doba do desítek ns, spolehlivé, energ. závislé i nezávislé, přímý přístup, statické i dynamické
- vnější pro dlouhodobé ukládání programů a (jiných) dat, např. pevné disky, výměnná média (CD/DVD, paměťové karty, aj.) a jiná disková zařízení
 - větší kapacity (až stovky TB), nižší přenosové rychlosti (do jednotek GB/s), přístupová doba ms (přímý přístup) až min. (sekvenční přístup), méně spolehlivé, energ. nezávislé, statické

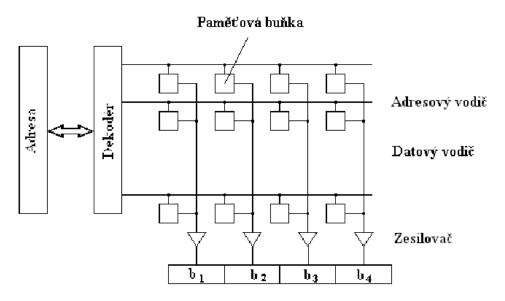


Vnitřní paměti

Obrázek: Struktura vnitřní paměti

- zapojeny jako matice paměťových buněk s kapacitou 1 bit
- po bytech adresovány hodnotou adresy na adresní části sběrnice, dekódované (binárním) dekodérem, který vybere adresový vodič (nastaví log. I)
- na výstupu datové části sběrnice zesilovače
- typy:
 - pouze pro čtení (ROM, Read Only Memory) energ. nezávislé, použití např. firmware (BIOS, karty)
 - i pro zápis např. RAM (Random Access Memory, s náhodným přístupem), energ. závislé, rychlejší než ROM, použití všude jinde než ROM







Paměti ROM

■ ROM – data trvale a neměnně "zapsána" při výrobě, použité obvody pro buňky určují uloženou hodnotu

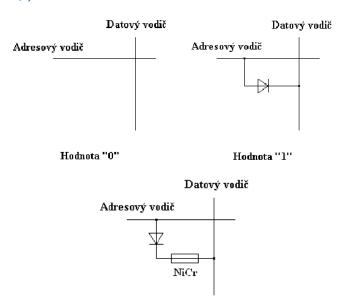
Obrázek: Realizace buňky paměti ROM

PROM (Programmable ROM) – z výroby samé log. I, jediný zápis pomocí programátoru PROM – proudem cca 10 mA se přepálí NiCr pojistka a tím se "zapíše" log. 0

Obrázek: Realizace buňky paměti PROM

■ EPROM (Erasable PROM) – uchování log. hodnoty pomocí el. náboje – kondenzátoru s velkým svodovým odporem, zápis pomocí programátoru EPROM, výmaz celé paměti odvedením náboje např. pomocí UV záření







Paměti ROM

- **EEPROM (Electrically EPROM)** uchování log. hodnoty pomocí tranzistorů, výmaz působením el. impulsů
- Flash EEPROM přepisovatelná → RAM, ale pomalejší a nižší max. počet zápisů (jednotky až desítky tis.) → FTL mezivrstva pro rozložení zápisů na celou paměť, organizace po blocích (desítky až stovky kB), "buňky" z NAND nebo NOR hradel 1 (SLC) a více bitů (MLC, TLC, QLC), dnes používaná i pro vnější paměti (NAND např. paměťové karty, Flash a SSD disky, NOR vestavěné)

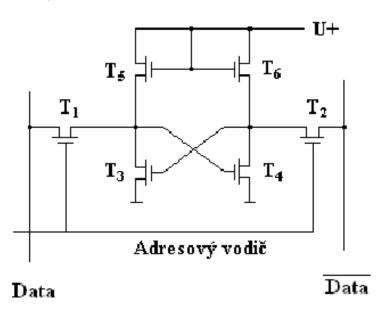


Statická RAM (SRAM)

- rychlé (přístupová doba jednotky ns, rychlost až desítky TB/s), ale složité → použití: cache paměti
- realizace buňky: bistabilní klopný obvod, např. v technologii MOS 2 datové vodiče: Data pro zápis, Data pro čtení (negace uložené hodnoty)

Obrázek: Realizace buňky paměti SRAM v technologii MOS





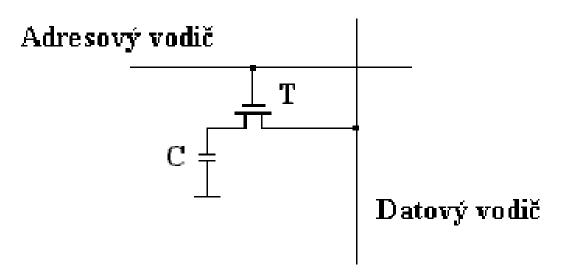


Dynamická RAM (DRAM)

- uchování log. hodnoty pomocí el. náboje kondenzátoru, který se samovolně i čtením vybíjí ⇒ potřeba periodicky obnovovat (čipsetem) = refresh
- kondenzátor + refresh = větší přístupová doba (jednotky až desítky ns), menší rychlost (až desítky GB/s), ale jednoduché \rightarrow použití: operační paměti

Obrázek: Realizace buňky paměti DRAM v technologii TTL







Dynamická RAM (DRAM)

- typy:
 - FPM (Fast Page Mode) využívá se toho, že data jsou v souvislé oblasti paměti a přístup je pomocí stránkování paměti, 1. byte plným počtem taktů, následující menším, např. 5-3-3 = časování paměti, moduly DIP a SIPP
 - EDO (Extended Data Output) částečné překrývání operací přístupu do paměti, časování např. 5-2-2-2, moduly SIMM
 - SDRAM (Synchronous DRAM) synchronní s frekvencí procesorové sběrnice základní desky, časování typicky 5-1-1-1, moduly DIMM
 - DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) 2 datové přenosy v 1. cyklu (na vzestupné i sestupné hraně taktu), např. DDR 200–400 (100–200 MHz, PC1600–3200), DDR2 400–1066 (200–533 MHz, PC2-3200–8500), DDR3 800–2133 (400–1066 MHz, PC3-6400–17000)
 - RDRAM (Rambus DRAM) speciální paměťová sběrnice (rychlejší 800 MHz, užší), podpůrné čipy pro komunikaci s řadičem paměti v modulu RIMM, dnes nepoužívané



Dynamická RAM (DRAM)

- moduly:
 - DIP, SIPP do procesorů Intel 80286, v patici na základní desce, FPM
 - SIMM (Single Inline Memory Module) čipy na podélné destičce plošného spoje = karta do slotu/banky na základní desce, první 30 pinů, 8/16-bitové, 256 kB až 4 MB, FPM, pro Intel 80286 až 80486, další 72 pinů, 32-bitové, 4–64 MB, EDO
 - DIMM (Dual IMM) 168/184/240 pinů, 64-bitové, 16 MB až 4 GB, SO-DIMM a MICRODIMM pro notebooky (72/144/200/204 a 144/172/214 pinů), (DDR) SDRAM
 - **RIMM (Rambus IMM)** 184/232/326 pinů, 16–64-bitové, 64 MB až 1 GB, SO-RIMM (160 pinů), RDRAM

Obrázek: Moduly a sloty pro operační paměti

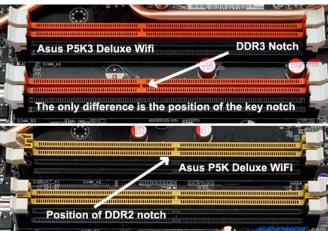
 výrobci: Transcend, Corsair Memory, Kingmax, Kingston Technology, Samsung Electronics a další

CMOS RAM (Complementary Metal Oxide Silicon)

- nepatrná klidová spotřeba, zálohované baterií na základní desce
- použití: konfigurační data BIOSu









Paměť cache

- = **vyrovnávací paměť** mezi různě rychlými zařízeními (na frekvenci rychlejšího), např. procesorem a operační pamětí, pamětí a diskovým zařízením apod.
- rychlejší zařízení používá paměť cache, do které se načtou data z pomalejšího zařízení, celá oblast/blok obsahující požadovaná data
- v případě operační paměti využití toho, že programy používají (souvislé) oblasti paměti, pro instrukce i data
- cache hit = požadovaná data jsou v cache
- **cache miss** = požadovaná data nejsou v cache a musí se načíst z pomalejšího zařízení
- organizace do bloků, při přeplnění vyřazní bloků algoritmem LRU (Least Recently Used) nejdéle nepoužívaný

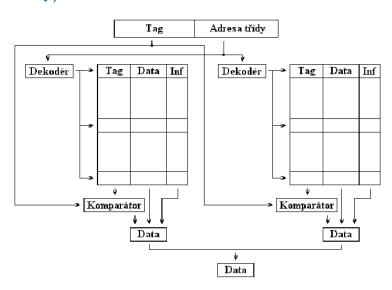


Paměť cache

- adresa paměti = části klíč (tag), index (třída), offset v bloku dat
- přímo mapovaná = tabulka s řádky pro indexy a sloupci klíč, blok dat a další informace (platnost dat, pro LRU, synchronizační u více cache pamětí aj.)
 - lacktriangle k bloku dat se přistupuje na základě indexu (bin. dekodér) + 1 porovnání klíče (bin. komparátor)
 - lacktriangle adresy se stejným indexem mapované do stejného bloku ightarrow hodně cache miss \Rightarrow nízký výkon
- plně asociativní ~ jednořádkové tabulky
 - k bloku dat se přistupuje pouze na základě porovnání klíče, adresa bez indexu
 - velký klíč, hodně porovnání (složitá konstrukce) ⇒ nepoužívají se
- n-cestně asociativní = n tabulek
 - k bloku dat se přistupuje na základě indexu a porovnání klíče
 - lacktriangle méně cache miss, menší klíč, méně (n) porovnání \Rightarrow nejpoužívanější, např. n=4 nebo 8
 - přímo mapovaná = 1-cestně asociativní

Obrázek: Schéma cache paměti







Paměť cache

- zápis dat přes cache do pomalejšího zařízení:
 - write-through ihned při zápisu do cache
 - write-back až později, např. při přeplnění cache, vyšší výkon

L1 (primární, first level cache)

- mezi procesorem a procesorovou sběrnicí, dnes zvlášť instrukční a datová (Harvardská koncepce)
- 8–32 kB, součást procesoru, od procesoru Intel 80486 (4-cestně asociativní)

L2 (sekundární, second level cache)

- mezi procesorovou sběrnicí a operační pamětí, pro urychlení práce s pamětí
- 32 kB až 6/1 MB (externí/interní), na základní desce (dříve) i jako součást procesoru (pouzdro, čip), od procesoru Intel 80386
- dnes i L3 cache až 12 MB, součást procesoru, od Intel Core